

Inhaltsverzeichnis

Embedding-Technologien und ihre Wertschöpfungskette bei elektronischen Baugruppen

Teil 1: Embedding-Technologien als Steigerung der Wertschöpfung in der Leiterplatte

Moderation: Dr. Klaus-Dieter Lang, Fraunhofer IZM, Berlin

Embedding-Technologien – ein Überblick zu Entwicklungsstand, Märkten und Anwendungen	11
Hannes Stahr, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Leoben, Österreich	

Zukünftige Entwicklungen zum Embedding in Polymersubstraten	29
Andreas Ostmann, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlin	

Hochwertige Schablonentechnik für die Integration höhenverteilter Komponenten in die Leiterplatte	41
Harald Grumm, Christian Koenen GmbH, Ottobrunn	

Chip-Einbettung in Multilayer Substrate	49
Thomas Gottwald, Schweizer Electronic AG, Schramberg	

Dünncip-Montage für Embedding	61
Hannes Kostner, Datacon Technology GmbH, Radfeld, Österreich	

Die funktionelle Integration von aktiven und passiven Komponenten in die Leiterplatte im industriellen Umfeld	73
Dr. Jan Kostelnik / Frank Ebling, Würth Elektronik GmbH und Co. KG, Rot am See	

Teil 2: Anwenderanforderungen und Erfahrungen zum Einsatz von Embedding-Verfahren

Moderation: Dr. Werner Witte, BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa

Anwendung von Embedding Technologien aus Sicht eines Herstellers von Automobilelektronik	79
Thomas Hofmann / Bernhard Schuch, Continental AG, Nürnberg	

Einbett-Technologie in der Power-Elektronik	87
Dr. Oliver Hellmund, Infineon Technologies AG, Neubiberg	

Integration planarer Polymerwellenleiter 89
Dr. Felix Betschon, Vario-Optics AG, Heiden, Schweiz

Heatsinkleiterplatten für Power-LED-Anwendungen 103
Martin Sachs, db electronic Daniel Böck GmbH, Groß-Gerau

**Assembly und Packaging von Elektronikmodulen für medizinische
Implantate – ein Überblick 111**
Jörg Goßler, Micro Systems Engineering GmbH, Berg

**Zukünftige Leiterplatten- und Baugruppentechologien für Avionik und
Defence 127**
Josef Denzel, EADS Deutschland GmbH, Ulm

**Anwendungstrends und Marktfelder der Embedding-Technologien im
Vergleich zur Standard HDI-Technik 141**
Dr. Markus Riester, maris TechCon, Graz, Österreich

Messekalender 159